

PCN # 20150316002
一部製品 Cu(銅)ワイヤ追加

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知 **Page 3** 記載の変更実施予定日 (**proposed 1st ship date**) 以降に予定いたしております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20150316002	PCN 日付:	03/20/2015																														
表題:	一部製品 Cu(銅)ワイヤ追加																																
PCN 詳細																																	
変更内容:																																	
TI は、下記 Product affected セクション記載の製品について、追加 bond wire option として Cu(銅) の認定を連絡します。対象製品は、現行組立サイトにおいて製造され、(ワイヤ以外)他の部材の変更はありません。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pkg Family</th> <th>Wire From</th> <th>Wire To</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JRBGA</td> <td>Au, 0.96 mil</td> <td>Cu, 0.8 mil</td> </tr> <tr> <td>QFN</td> <td>Au, 0.96 mil, 1.3 mil, 1.97mil</td> <td>Cu, 0.8 mil, 0.96 mil, 1.98 mil</td> </tr> <tr> <td>SOIC</td> <td>Au, 0.9 mil, 1.15 mil, 1.31 mil</td> <td>Cu, 0.96 mil</td> </tr> <tr> <td>SOP</td> <td>Au, 1.15 mil</td> <td>Cu, 0.96 mil</td> </tr> <tr> <td>SSOP</td> <td>Au, 0.96 mil</td> <td>Cu, 0.96 mil</td> </tr> <tr> <td>TQFP</td> <td>Au, 0.8 mil, 0.96 mils</td> <td>Cu, 0.8 mil, 0.96 mil</td> </tr> <tr> <td>TSSOP</td> <td>Au, 0.96 mil</td> <td>Cu, 0.96 mil</td> </tr> <tr> <td>TVSOP</td> <td>Au, 0.8 mil</td> <td>Cu, 0.96 mil</td> </tr> <tr> <td>UBGA</td> <td>Au, 0.96 mil</td> <td>Cu, 0.8 mil</td> </tr> </tbody> </table>				Pkg Family	Wire From	Wire To	JRBGA	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil	QFN	Au, 0.96 mil, 1.3 mil, 1.97mil	Cu, 0.8 mil, 0.96 mil, 1.98 mil	SOIC	Au, 0.9 mil, 1.15 mil, 1.31 mil	Cu, 0.96 mil	SOP	Au, 1.15 mil	Cu, 0.96 mil	SSOP	Au, 0.96 mil	Cu, 0.96 mil	TQFP	Au, 0.8 mil, 0.96 mils	Cu, 0.8 mil, 0.96 mil	TSSOP	Au, 0.96 mil	Cu, 0.96 mil	TVSOP	Au, 0.8 mil	Cu, 0.96 mil	UBGA	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil
Pkg Family	Wire From	Wire To																															
JRBGA	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil																															
QFN	Au, 0.96 mil, 1.3 mil, 1.97mil	Cu, 0.8 mil, 0.96 mil, 1.98 mil																															
SOIC	Au, 0.9 mil, 1.15 mil, 1.31 mil	Cu, 0.96 mil																															
SOP	Au, 1.15 mil	Cu, 0.96 mil																															
SSOP	Au, 0.96 mil	Cu, 0.96 mil																															
TQFP	Au, 0.8 mil, 0.96 mils	Cu, 0.8 mil, 0.96 mil																															
TSSOP	Au, 0.96 mil	Cu, 0.96 mil																															
TVSOP	Au, 0.8 mil	Cu, 0.96 mil																															
UBGA	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil																															
変更理由:																																	
供給能力確保 1) 業界技術動向に合わせて、向上した機械的/電気的特性のワイヤを使用します。 2) 組立/検査量産サイトの柔軟性を最大限にします。 3) Cu(銅)は、入手及び保管がより容易になります																																	
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																																	
なし																																	

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等